

国泰君安证券股份有限公司

关于

深圳市志橙半导体材料股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）



国泰君安证券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

国泰君安证券股份有限公司
关于深圳市志橙半导体材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书

深圳证券交易所：

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国泰君安”）接受深圳市志橙半导体材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“志橙半导体”、“公司”）的委托，担任志橙半导体首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行上市”）的保荐机构。

保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《深圳市志橙半导体材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。

目录

目录.....	2
一、发行人基本情况	4
（一）基本信息.....	4
（二）主营业务.....	4
（三）核心技术和研发水平.....	5
（四）主要经营和财务数据及指标.....	8
（五）主要风险.....	9
二、发行人本次发行情况	17
三、本次发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员	18
（一）具体负责本次推荐的保荐代表人.....	18
（二）项目协办人及其他项目组成员.....	18
（三）本次证券发行项目组成员联系方式.....	19
四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及业务往来情况	19
五、保荐机构承诺事项	20
（一）保荐机构对本次发行上市保荐的一般承诺.....	20
（二）保荐机构对本次发行上市保荐的逐项承诺.....	20
六、保荐机构对本次发行上市的推荐结论	21
七、本次证券发行履行的决策程序	21
八、保荐机构关于发行人是否符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件的逐项说明	21
（一）发行人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 2.1.1 条之“（一）符合中国证券监督管理委员会规定的创业板发行条件”规定.....	21
（二）发行人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 2.1.1 条之“（二）发行后股本总额不低于 3,000 万元”规定.....	24
（三）发行人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 2.1.1 条之“（三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过 4 亿元的，公	

开发行股份的比例为 10%以上”规定	24
(四)发行人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 2.1.1 条之“(四)市值及财务指标符合本规则规定的标准”规定.....	24
(五)发行人符合《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定(2022 年修订)》第三条第(一)项创业板定位相关指标规定.....	24
(六)发行人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 2.1.1 条之“(五)本所要求的其他上市条件”规定.....	25
九、保荐机构关于发行人符合创业板定位及国家产业政策的专业判断	25
十、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排	26

一、发行人基本情况

（一）基本信息

中文名称	深圳市志橙半导体材料股份有限公司
英文名称	Shenzhen Zhicheng Semiconductor Materials Co, Ltd.
注册资本	6,000 万元
法定代表人	朱佰喜
有限公司成立时间	2017 年 12 月 26 日
整体变更为股份公司时间	2022 年 12 月 7 日
注册地址	深圳市宝安区松岗街道潭头社区健仓科技研发厂区办公楼 307
邮政编码	518105
电话	020-26282904
传真	020-26282804
互联网网址	https://www.orangecvd.com
电子信箱	orange@zcsemicon.com
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会办公室
信息披露和投资者关系部门负责人	胡婷
信息披露和投资者关系部门电话	020-26282904

（二）主营业务

公司是一家主要研发、生产、销售用于半导体设备的碳化硅涂层石墨零部件产品，并提供相关碳化硅涂层服务的国家级专精特新“小巨人”企业，主要产品可用于碳化硅（SiC）外延设备、MOCVD 设备、硅（Si）外延设备等多种半导体设备反应腔内，参与外延片制造、晶圆制造等不同制造环节，其中碳化硅涂层石墨基座等产品直接与晶圆接触，对工艺过程中的温度场和气流场有较大影响，直接影响相关设备制造产品的性能。

公司零部件产品具有高纯度、耐高温、耐腐蚀、高精度等特点，工艺相对复杂，需经过设备厂商、外延片厂商、晶圆厂商长期验证。一方面，公司通过定制化生产，产品可以服务于不同型号、不同工艺的设备，可以满足不同设备厂商的多样化需求，服务不断迭代的半导体设备市场。另一方面，公司产品长期处于高

温、腐蚀性等恶劣反应环境中，在设备正常使用过程中会出现正常损耗，因此需定期更换以保障性能和质量，具有耗材的特征；公司产品作为外延片厂商、晶圆厂商日常生产中需要替换的零部件，可以持续稳定满足市场存量设备使用过程中更换零部件的需求。

同时，公司通过工艺改进提升、新产品研发等手段挖掘市场需求，坚持开发一代、储备一代、销售一代的发展战略，积极开展外延、刻蚀、氧化扩散和晶体生长等半导体设备用实体碳化硅零部件、烧结碳化硅零部件和碳化钽涂层石墨零部件等新产品研发，并陆续进入试制、验证阶段。公司致力于成为全球半导体设备零部件、材料领域的一流企业，持续推动半导体关键碳化硅零部件的技术进步。

（三）核心技术和研发水平

公司目前所掌握的核心技术均通过产品的自主研发和优化、生产设备的自主设计和改造、工艺技术的自主创新和改进而积累形成。公司通过多年技术研发，在半导体设备用碳化硅涂层石墨零部件领域掌握了相关核心技术，并在持续提高产品工艺性能、一致性、可靠性，在提升客户产品良率、使用寿命、降低成本等方面不断进行创新和改进。

上述核心技术在公司销售的产品中得以持续应用并形成公司产品的竞争力。截至本上市保荐书签署日，公司主要核心技术及来源如下：

序号	核心技术名称	技术来源	技术水平	具体表征	技术分类	应用产品	所处阶段
1	CVD 炉的高温均一性热场系统技术	自主研发	国内先进	SiC CVD 涂层工艺反应,需要在最高 1500°C的大尺寸反应空间下进行。公司通过有限元分析技术进行 CVD 沉积炉反应腔内的热场模拟分析,采用实验数据验证、迭代的方式,逐步提升热场设计能力并实现加热器形状、隔热材料优化等热场结构与尺寸的优化,合理设计出配套的热场、加热器元件与结构,实现体积超过 6 立方米的 CVD 沉积炉内不同位点反应工艺温度精度可达 $\pm 3^{\circ}\text{C}$	设备相关	SiC 外延设备零部件、MOCVD 设备零部件、Si 外延设备零部件及涂层服务	已量产
2	CVD 炉的高精度气体流场控制技术	自主研发	国内先进	公司通过开发高精度气体流量控制技术,多通道、多方向和气体孔径设计的气体导入均匀化技术,稳定抽气控制技术,以保证 CVD 沉积炉反应腔内各向气流均匀性。通过气流控制,结合 CVD 炉的高温均一性热场系统技术,从而有助于获得高均匀的 CVD SiC 薄膜,膜厚均匀性可达 $\pm 10\mu\text{m}$	设备相关	SiC 外延设备零部件、MOCVD 设备零部件、Si 外延设备零部件及涂层服务	已量产
3	CVD 炉内高温旋转技术	自主研发	国内先进	公司不断优化 CVD 炉内旋转机构的结构、用材、传动方式、旋转控制方式,从而实现高温、强腐蚀性工艺条件下的 CVD 炉旋转机构的长期平稳旋转和稳定可控,实现无级变速,满足不同种类产品对转速的要求	设备相关	SiC 外延设备零部件、MOCVD 设备零部件、Si 外延设备零部件及涂层服务	已量产
4	半导体设备零部件设计及精密加工技术	自主研发	国内先进	半导体设备内在构造精密,对于零部件结构、功能、材料、性能等要求高。公司具备研发、设计、精密加工多种半导体设备零部件的技术。以碳化硅涂层石墨基座产品为代表,其规格大(最大型号直径接近 800 毫米),在半导体设备中运行的工作转速极高(20 转/秒),对于承载单个晶圆的片坑(pocket)的尺寸精度要求极高,从而保证晶圆在高温、高速旋转状态下不发生飞片(晶圆脱离 pocket 的现象)。公司通过优化 CAM 程序、前后各环节加工工艺,并结合高均匀性 SiC CVD 涂层技术成功研发出涂层后 pocket 尺寸精度在 $\pm 5\mu\text{m}$ 以内的石墨基座产品	工艺与产品相关	SiC 外延设备零部件、MOCVD 设备零部件、Si 外延设备零部件	已量产
5	β -SiC CVD 的配方及工艺技术	自主研发	国内先进	用 CVD 法制备 β -SiC,当气体流量、压力、温度等参数发生微小变化时,均会对晶体生长的质量产生重大影响,工艺窗口很窄。在生长的不同阶段,需要合理的生长环境参数及控制方法,从而实现在大尺寸石墨基体上生长高质量的 β -SiC	工艺与产品相关	SiC 外延设备零部件、MOCVD 设备零部件、Si 外延设备零部件及涂层服务	已量产

序号	核心技术名称	技术来源	技术水平	具体表征	技术分类	应用产品	所处阶段
				薄膜			
6	高均匀性 SiC CVD 涂层技术	自主研发	国内先进	发行人通过热力学计算，结合温场、流场模拟，获得高均匀性的温度场和气流场，结合前驱体补偿、基座旋转等措施，获得高均匀的 CVD SiC 薄膜；通过控制反应温度、气体流量以及压强，优化表面晶体形貌，从而实现不同涂层批次的产品之间碳化硅薄膜表面粗糙度均不超过 2.5 μ m	工艺与产品相关	SiC 外延设备零部件、MOCVD 设备零部件、Si 外延设备零部件及涂层服务	已量产
7	β -SiC CVD 的涂层“点缺陷”控制技术	自主研发	国内先进	涂层零部件种类多，形状各异，最大直径达到 800 毫米，长期在半导体设备反应腔内 NH ₃ 、Cl ₂ 、HCl 等强腐蚀性的超高温反应气体环境中使用，对涂层的一致性、稳定性、寿命（不能有裂纹和破孔）要求非常高。大面积 CVD 碳化硅的缺陷，尤其是“点缺陷”非常难控制。一旦在半导体设备使用过程中零部件涂层出现缺陷破损，涂层产品的基础材料会迅速被腐蚀，形成空洞、内蚀，从而对客户的晶圆质量产生重大影响。公司通过优化 CVD 过程的反应参数、工艺技术、工序环节等，减少了“点缺陷”的发生，满足了客户的使用要求	工艺与产品相关	SiC 外延设备零部件、MOCVD 设备零部件、Si 外延设备零部件及涂层服务	已量产

(四) 主要经营和财务数据及指标

1、主要经营数据

报告期内，公司主营业务收入主要来源于半导体设备零部件销售和提供涂层服务，两项业务收入占比约 90%。报告期内，公司主营业务收入按产品分类构成情况如下：

单位：万元

项目	2023 年 1-6 月		2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
半导体设备零部件	18,555.68	74.28%	19,422.71	70.41%	10,368.20	87.04%	3,913.59	92.11%
SiC 外延设备零部件	11,847.70	47.43%	11,009.71	39.91%	2,448.77	20.56%	455.27	10.72%
MOCVD 设备零部件	5,360.48	21.46%	6,605.21	23.94%	6,409.54	53.81%	2,789.20	65.65%
Si 外延设备零部件	1,294.88	5.18%	1,779.83	6.45%	1,489.79	12.51%	647.27	15.23%
其他零部件	52.62	0.21%	27.96	0.10%	20.10	0.17%	21.85	0.51%
涂层服务	2,528.38	10.12%	5,296.19	19.20%	920.18	7.73%	245.63	5.78%
外购零部件	3,895.98	15.60%	2,866.10	10.39%	622.94	5.23%	89.48	2.11%
合计	24,980.05	100.00%	27,585.01	100.00%	11,911.31	100.00%	4,248.70	100.00%

2、主要财务数据及财务指标

项目	2023 年 1-6 月 /2023.6.30	2022 年度 /2022.12.31	2021 年度 /2021.12.31	2020 年度 /2020.12.31
资产总额（万元）	77,426.17	56,681.92	22,546.19	9,721.86
归属于母公司所有者权益 （万元）	58,106.71	46,087.96	18,966.36	8,320.61
资产负债率（母公司）	32.88%	26.70%	24.85%	23.92%
营业收入（万元）	25,166.23	27,591.31	11,913.20	4,248.92
净利润（万元）	11,186.32	11,474.76	5,145.75	1,550.42
归属于母公司所有者的净利润 （万元）	11,186.32	11,474.76	5,145.75	1,550.42
扣除非经常性损益后归属于母 公司所有者的净利润（万元）	11,169.40	11,447.65	5,131.79	1,654.89
基本每股收益（元/股）	1.86	1.91	不适用	不适用
稀释每股收益（元/股）	1.86	1.91	不适用	不适用
加权平均净资产收益率（%）	21.47	35.83	42.52	62.28

项目	2023 年 1-6 月 /2023.6.30	2022 年度 /2022.12.31	2021 年度 /2021.12.31	2020 年度 /2020.12.31
经营活动产生的现金流量净额 (万元)	4,836.77	5,798.40	797.85	542.11
现金分红 (万元)	-	2,122.01	-	-
研发投入占营业收入的比例(%)	8.35	9.82	11.48	10.20

(五) 主要风险

1、与发行人相关的风险

(1) 经营风险

1) 与国际同业在产品线覆盖广度方面存在较大差距的风险

报告期内，公司主要产品包括 SiC 外延设备、MOCVD 设备、Si 外延设备用碳化硅涂层石墨零部件，并持续开发半导体设备用实体碳化硅零部件、烧结碳化硅零部件等新产品。

在半导体设备用碳化硅涂层石墨零部件领域，东海碳素、崇德昱博、西格里碳素、东洋炭素、阔斯泰等国际龙头成立时间长，且北美、欧洲、日韩等地区半导体市场发展程度高，国际材料及零部件龙头公司产品线布局相对完善。东海碳素主要产品包括石墨电极、高纯石墨等石墨制品和碳化硅组件、耐磨材料等结构制品；崇德昱博主要产品包括碳化硅涂层石墨、石英、陶瓷和硅产品；阔斯泰主要产品包括氧化铝陶瓷、氮化铝陶瓷、碳化硅陶瓷及其他产品。

更广泛的产品覆盖程度可以使得半导体设备零部件企业为客户提供更为全面、综合的产品及服务。现阶段，公司产品线覆盖广度方面与上述国际巨头尚存在一定差距，公司在行业内的综合竞争力与国际龙头企业相比仍存在不足。如果未来发行人未能成功拓展新产品，且碳化硅涂层石墨零部件产品的优势地位被其他企业所替代，可能对发行人生产经营产生不利影响。

2) 原材料供应风险

报告期内，公司生产所需的特种石墨材料均通过外购方式取得，部分原材料原产地位于国外。报告期内，公司各期石墨采购金额分别为 501.38 万元、1,476.48 万元、3,645.98 万元和 1,282.70 万元，占公司各期采购总额的比例分别为 45.00%、

42.51%、44.82%和 21.56%。

若未来现有石墨材料供应商受贸易政策或其他因素影响，导致公司不能及时足额采购相关原材料，且公司短期内无法寻求替代供应商，将对公司生产经营产生不利影响。

3) 主营业务毛利率下滑的风险

2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 1-6 月，公司主营业务毛利率分别为 72.77%、78.14%、78.49%和 72.83%，毛利率保持在较高水平。2023 年上半年，公司广州生产基地已完成建设，相关资产由在建工程转入固定资产核算，公司的固定资产折旧金额有所上升。由于广州基地转产后产能需要在一定周期内逐步提升，因此短期内可能造成公司毛利率的下降。从长期来看，近年来下游市场需求和行业竞争格局不断变化，国内竞争对手进行多轮大额融资，引入产业资本股东并大力扩张产能，**在产能完全释放的情况下，市场总供给规模大幅提升，行业竞争激烈程度将进一步增加**。公司后续经营面临因下游市场需求变化、行业竞争加剧导致公司毛利率大幅下滑的风险。未来，如果行业竞争长期加剧，发行人将主要面临通过降价与国内竞争对手竞争、以及相关原材料因采购需求上升而价格上升的成本压力，以 2022 年发行人主营业务毛利率 78.49%为基准，相关因素影响对发行人主营业务毛利率的敏感性分析如下：

主营业务毛利率测算	销售价格下降 10%	销售价格下降 30%	销售价格下降 50%
直接材料成本上升 10%	75.34%	68.29%	55.61%
直接材料成本上升 30%	73.82%	66.33%	52.87%
直接材料成本上升 50%	72.29%	64.38%	50.13%

注：直接材料成本上升按 2022 年度自制产品主营业务成本中直接材料占比 31.84%为基准测算”

4) 业绩增速放缓或业绩下滑风险

报告期内，公司营业收入、净利润增速较快，盈利能力较强。报告期内，半导体行业总体保持增长态势。然而，半导体行业受国际经济波动、终端消费市场需求变化等方面影响，其发展往往呈现一定的周期性波动特征。在行业景气度较高时，半导体制造企业往往加大资本性支出，快速提升对半导体设备及零部件的

需求；但在行业景气度下降过程中，半导体企业则可能削减资本支出，从而对半导体设备和零部件的需求产生不利影响。

除上述行业周期影响外，如果未来发生宏观经济景气度下行、国家产业政策变化、国际贸易摩擦、地缘政治矛盾加剧、市场竞争加剧、国内主要竞争对手新增产能投产造成竞争加剧进而影响公司产品销售价格、公司不能有效拓展新客户、下游客户投资需求发生波动、研发投入未能及时实现产业转化、广州基地产能利用不达预期、发生知识产权纠纷、原材料供应受限或价格出现大幅波动、租赁厂房无法续租或被处罚、拆除等情形，将使公司面临一定的经营压力，导致公司未来业绩存在大幅波动、增幅大幅放缓、业绩下滑甚至出现亏损的风险。

5) 原材料价格波动风险

报告期内，公司原材料采购占公司采购总额的比例分别为 58.55%、55.06%、53.50%和 30.04%，原材料主要包括石墨材料和涂层材料（包括硅源材料、碳源材料及辅助气体）。近年来，随着半导体、锂电、光伏太阳能等领域对特种石墨材料的需求不断增长，以及供给低于需求等因素影响，石墨材料市场价格呈现一定波动。报告期内，公司石墨材料采购价格分别为 57.88 元/千克、80.05 元/千克、83.28 元/千克和 78.03 元/千克，整体呈上升趋势。

以 2022 年度公司毛利率 78.49%为基准，按 2022 年度自制产品主营业务成本中直接材料占比 31.84%测算，若直接材料平均价格上涨 30%，公司毛利率将下降 1.82 个百分点。如果未来石墨等原材料价格波动加剧，将可能会对公司经营业绩产生不利影响。

6) 租赁物业风险

报告期内，公司的生产经营场所主要通过租赁方式取得。

公司租赁的部分物业属于集体土地上建造的房产但所在集体土地未办理流转手续、部分物业实际用途与证载用途不一致，部分物业的出租方未能提供产权证书或相关主管部门批准房屋建设的许可文件或其有权出租的其他证明文件、部分物业未完成租赁备案手续，存在被有权部门责令改正或处罚的风险。虽然公司对经营场所的租赁行为一直处于持续稳定状态，但不排除出现上述物业拆除、租赁合同不能继续履行、到期无法续租或租金大幅上涨、租赁过程中发生出租方违

约等情形。

如果发生上述情形，则公司可能需要搬迁而产生额外费用，在短期内亦可能会影响公司正常经营。

(2) 技术风险

1) 研发失败的风险

受产业链发展不平衡影响，国内本土半导体设备零部件厂商整体仍处于发展初期，规模较小，国产化率低，下游半导体设备客户对于国产零部件厂商仍处于合作、培育初期。公司需不断开发新产品以满足下游客户不同设备内各相关零部件产品性能、质量的需求。半导体设备零部件行业属于技术密集型行业，具有研发投入高、研发周期长、研发风险大等特点。

若公司在研发过程中未能实现关键技术的突破，或产品性能无法达到预期，无法通过下游客户验证，则可能出现研发失败的风险。

2) 技术人才流失的风险

半导体设备零部件设计、研发与制造涉及多个交叉学科，产品规格型号多，工艺技术复杂。公司经过多年发展，培养及招聘了一批具有相关学科专业知识和实践经验的研发团队。截至 2023 年 6 月 30 日，公司共有 58 名研发人员，占公司全部员工的 17.37%。

随着未来行业高速发展、国产替代趋势加快，人才资源的竞争也将日趋激烈，若公司未来不能持续加强对原有研发团队的激励和新人才的引进，则存在人才流失的风险，将对公司的持续发展造成不利影响。

3) 核心技术泄密的风险

作为半导体产业链上游基石行业，半导体设备碳化硅零部件行业技术含量高，进入壁垒高，产品制造不仅需要高性能的生产设备，还需要纯熟的生产工艺及材料配方支持。公司的产品创新和技术优势主要体现在自主研发形成的生产设备及生产工艺，相关核心技术即为公司核心竞争力重要构成因素，其安全是公司未来得以持续发展的基础。

若公司相关核心技术的保密机制不能得到有效执行，或因行业中可能的不正

当竞争等使得核心技术泄密，将导致公司丧失技术先发优势，进而影响公司未来经营发展。

(3) 财务风险

1) 应收账款的回收风险

报告期各期末，公司应收账款的账面价值分别为 1,222.92 万元、3,362.57 万元、7,205.58 万元和 13,308.88 万元，占总资产的比例分别为 12.58%、14.91%、12.71%和 17.19%，公司应收账款周转率分别为 4.84、4.92、4.94 和 4.65¹。报告期内，随着业务扩张、销售规模不断扩大，公司应收账款余额快速提高，坏账准备有所增长。

如未来公司应收账款增长速度过快、主要客户付款或经营状况出现不利变化，公司应收账款周转率可能下降，计提的坏账准备可能增加，继而可能对公司的生产经营和业绩造成不利影响。

2) 存货增加及跌价的风险

报告期各期末，公司存货的账面价值分别为 638.95 万元、2,108.53 万元、5,655.49 万元和 6,391.30 万元，占总资产的比例分别为 6.57%、9.35%、9.98%和 8.25%，公司存货周转率分别为 2.48、1.85、1.51 和 2.28²。报告期内，随着行业景气度持续高涨，公司业务扩张，客户新增订单较多，公司原材料、库存商品、在产品存货余额快速提高。

如未来公司不能保持对存货的有效管理，较大的存货规模将会对公司流动资金产生一定压力，且可能导致存货跌价准备上升，将对公司的资金周转或业绩造成不利影响。

3) 税收优惠政策变动的风险

发行人母公司深圳志橙、子公司东莞志橙、广州志橙报告期内曾享受高新技术企业税收优惠并减按 15%税率缴纳企业所得税。截至本招股说明书签署日，由于公司管理架构调整，各法人主体职能定位重新划分，深圳志橙不再申请高新技

¹ 为便于对比，2023 年 1-6 月公司的应收账款周转率数据已做年化处理。

² 为便于对比，2023 年 1-6 月公司的存货周转率数据已做年化处理。

术企业资质；东莞志橙相关资质已于 2023 年 12 月到期，已继续提交资质认定申请；广州志橙相关资质将于 2025 年 12 月到期。

若未来东莞志橙或广州志橙未能持续获得高新技术企业认定，公司将不能继续享受前述税收优惠，公司存在税收优惠政策变动的风险。

（4）内部控制风险

1) 经营规模扩张引致的管理风险

公司产品型号较多，下游客户具体需求也存在差异，因此对公司的综合管理能力要求较高。报告期内，随着公司业务不断发展，公司生产经营规模持续增长、组织架构日益庞大，且募投项目建成投产后公司将变为东莞、广州两地生产模式，将对公司在资源整合、市场开拓、产品研发、质量管理、内部控制等方面的能力和水平提出更高要求。

如果公司的组织模式、管理制度、管理能力未能随着公司规模扩张及时调整完善，管理水平无法适应公司快速发展，不能及时匹配公司经营规模增长，将使公司面临规模扩张导致的管理风险，将影响公司的生产经营和长远发展。

2) 实际控制人直接持股比例较低的风险

本次发行前，公司实际控制人朱佰喜直接持有公司 930.2494 万股股份，占公司股本总额的 15.50%，朱佰喜通过直接持股、控制三个持股平台及一致行动关系合计控制发行人 37.32%的股份对应的表决权。

假设本次公开发行股份 2,000 万股，本次发行完成后，朱佰喜直接持股比例为 11.63%，控制公司的表决权比例为 27.99%，有所降低。根据一致行动协议，朱佰喜和祝文闻一致行动期限自该协议签署日起至公司股票于证券交易所首次公开发行并上市之日起满三（3）年之日止，有效期届满后，经双方协商一致，可以延期。若未来一致行动协议到期未能延期、发生对控制权不利的变化、协议终止或其他股东谋求控制权地位，可能导致公司实际控制人变更，如果控制不当将会损害公司及公司其他股东的利益。

2、与行业相关的风险

(1) 市场竞争加剧的风险

全球半导体设备市场主要由北美、欧洲、日本等国际厂商主导，受产业链发展影响，配套半导体设备核心零部件制造商主要位于设备厂商所在区域。根据 QY Research 统计数据，2022 年全球 CVD 碳化硅零部件市场规模为 8.13 亿美元，发行人在全球市场占有率仅为 3.57%，与国际同业相比公司业务规模较小，资金实力较弱，产品类型较为单一。

基于半导体设备核心零部件行业资本及技术密集的特点，若公司不能增强技术储备、提高经营规模、增强资本实力，在行业全球化竞争中，可能导致公司市场竞争力下降、经营业绩下滑。

在下游市场需求带动和国家产业政策的支持下，更多国内厂商开始逐步进行半导体设备零部件、核心材料技术研发和业务拓展。近年来，德智新材料、六方科技、成都超纯、苏州铠欣等多家半导体设备用碳化硅零部件领域国内厂商进行外部融资，用于扩产、研发等用途，陆续进入下游客户进行产品验证，**如其他国内厂商短期内通过下游客户验证且新建产能快速释放，预计国内 CVD 碳化硅零部件总供给规模将快速提升，发行人产品价格、市场份额存在下滑的风险。**如果未来下游市场需求增长不及预期，或行业参与者增加，市场竞争加剧，可能对发行人市场占有率、产品定价、毛利率水平等产生不利影响，发行人在下游客户中的份额占比可能出现下降，乃至导致发行人重要客户流失，进而可能对公司未来业务发展与盈利能力造成不利影响。

(2) 宏观因素变动、行业周期性影响下游市场需求的风险

公司产品和服务主要客户为半导体及泛半导体领域设备厂商、外延片厂商、晶圆厂商，**发行人产品的下游及终端应用行业包括功率器件及新能源汽车市场、LED 芯片及 LED 市场、集成电路及消费电子市场、光伏硅片及光伏市场等。**受国内外宏观经济、市场需求、行业发展规律、产业政策等因素影响，近年来**下游及终端应用行业发展速度较快，但相关产业存在一定的周期性。**

功率器件及新能源汽车市场方面，目前碳化硅功率器件受新能源汽车市场规模持续增长带动而快速发展，但考虑到碳化硅功率器件属于资本性开支较大

的资本密集制造行业，从长期来看，可能会出现一定周期性。LED 芯片及 LED 市场、集成电路及消费电子市场、光伏硅片及光伏市场均存在一定的周期性。

公司的生产经营状况与下游景气程度密切相关，如果未来下游行业景气度下降或产业政策支持力度减弱，可能导致公司产品的市场需求有所下降，从而对公司的业务发展和经营业绩产生不利影响。

（3）豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险

由于公司属于技术密集型企业，部分信息涉及商业秘密，不宜对外披露。公司申请信息披露豁免的商业秘密包括客户、供应商名称等。上述部分信息豁免披露可能存在影响投资者对公司价值的正确判断，造成投资决策失误的风险。

（4）法律法规及行业政策变化的风险

公司所处的半导体设备零部件行业属于国家鼓励的基础性、战略性新兴产业，近年来，国家不断出台相关产业政策、税收优惠政策、技术扶持政策，对行业发展起到积极引导作用，推动企业加快产业结构升级和技术水平提升。若未来国家产业政策发生重大不利变化，或出台法律法规对公司生产经营提出新要求，发行人的发展前景将可能受到影响，进而给公司经营状况和盈利能力带来风险。

3、其他风险

（1）募投项目实施及产能消化风险

本次募集资金拟投资的 SiC 材料研发制造总部项目建成达产后，将大幅提升公司半导体设备零部件产能，有助于满足公司业务增长需要。如果未来市场环境、项目实施进度、公司管理能力等方面出现重大不利变化，公司可能面临募集资金投资项目无法顺利实施的风险。此外，若在项目实际建成后，国家政策环境发生变动、市场需求发生重大不利变化或出现行业竞争加剧、公司对新市场开拓不力等情况，可能面临新增产能无法及时消化的风险，进而对公司盈利能力产生不利影响。

（2）募投项目新增折旧摊销影响公司盈利能力的风险

根据募集资金使用计划，本次募集资金投资项目建成后，公司资产规模将大

幅增加，导致各年折旧和摊销费用相应增加。若募集资金投资项目不能较快产生效益以弥补新增固定资产投资带来的折旧和无形资产产生的摊销，则募投项目的投资建设将在一定程度上影响公司未来的净利润和净资产收益率。

(3) 净资产收益率和每股收益摊薄的风险

报告期内，公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为 66.48%、42.41%、35.74%及 21.44%，2022 年扣除非经常性损益后的每股收益为 1.91 元/股。本次发行将使得公司净资产规模上升、股本增加，而募集资金投资项目产生效益需要一定时间，从而存在公司即期回报可能被摊薄的风险。

(4) 发行失败的风险

公司本次发行将受到投资者对创业板认可程度、证券市场整体情况、公司经营业绩情况等诸多内外部因素影响。根据相关法律法规规定，若本次发行时出现认购不足的情形，则可能出现发行中止甚至发行失败的风险。

二、发行人本次发行情况

发行股票类型	人民币普通股（A股）
发行股数	本次公开发行新股数量不超过 2,000 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行公司股东不公开发售股份。本次发行可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的15%。最终发行股份数量以深圳证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会注册的数量为准
每股面值	人民币1.00元
每股发行价格	【】元/股
预计发行日期	【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所和板块	深圳证券交易所创业板
发行后总股本	不超过8,000万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）
保荐机构（主承销商）	国泰君安证券股份有限公司
发行方式	采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或监管部门认可的其他方式
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设A股股东账户的中国境内自然人、法人及其他投资者（中国法律或法规禁止者除外）
承销方式	余额包销

三、本次发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员

（一）具体负责本次推荐的保荐代表人

金亮先生：保荐代表人，硕士研究生。国泰君安证券股份有限公司投资银行部业务董事。自从事投资银行业务以来负责或参与的主要项目包括：青岛云路先进材料股份有限公司科创板 IPO、青岛海尔生物医疗股份有限公司科创板 IPO、鲁泰纺织股份有限公司可转换公司债券、东易日盛家居装饰集团股份有限公司非公开发行等项目。金亮先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

魏鹏先生：保荐代表人，硕士研究生。国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级执行董事。自从事投资银行业务以来负责或参与的主要项目包括：桑德环境资源股份有限公司配股、湖北凯乐科技股份有限公司重大资产重组、江苏中南建设集团股份有限公司非公开发行、北京元隆雅图文化传播股份有限公司 IPO、中国核工业建设股份有限公司可转换公司债券、青岛海尔生物医疗股份有限公司科创板 IPO、长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行、青岛云路先进材料股份有限公司科创板 IPO、长江精工钢结构（集团）股份有限公司可转换公司债券、中国核工业建设股份有限公司非公开发行等项目。魏鹏先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等有关规定，执业记录良好。

（二）项目协办人及其他项目组成员

1、项目协办人

丁寒玉女士，硕士研究生，国泰君安证券股份有限公司投资银行部执行董事。曾自从事投资银行业务以来负责或参与的主要项目包括：北京屹唐半导体科技股份有限公司科创板 IPO、国投资本股份有限公司可转换公司债券、中国核工业建设股份有限公司可转换公司债券、国投资本股份有限公司非公开发行、中国电力建设股份有限公司非公开发行、盈康生命科技股份有限公司重大资产重组、中盐内蒙古化工股份有限公司发行股份购买资产等项目。丁寒玉女士在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

2、其他项目组成员

项目组其他成员包括：王文庭、王林、卢堃（已离职）、王一羽、贾博文。

（三）本次证券发行项目组成员联系方式

联系地址	北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼16层
联系人	金亮、魏鹏
电话	010-83939187
传真	010-66162609

四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及业务往来情况

1、截至本上市保荐书出具日，国泰君安及控股公司国泰君安创新投资有限公司、国泰君安证裕投资有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、华安基金管理有限公司及参股公司上海科创中心股权投资基金管理有限公司、上海证券有限责任公司等主体在装备产投、上海创合等发行人股东的上层出资结构中不存在间接持股情形，合计持有发行人股份比例不超过 0.05%；此外，国泰君安实际控制人上海国际集团有限公司存在通过上海创合、杭州创合、装备产投等发行人直接股东间接持有发行人股份的情形，合计持有发行人股份比例不超过 0.02%。上述持股情形系相关投资主体或金融产品管理人依据市场化原则所作出的投资决策，不属于法律法规禁止持股的情形或利益冲突情形。

除此之外，保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其重要关联方股份的情况；

2、截至本上市保荐书出具日，发行人或其实际控制人、重要关联方不存在持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

3、截至本上市保荐书出具日，保荐机构的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员，不存在持有发行人或其重要关联方股份，以及在发行人或其重要关联方任职的情况；

4、截至本上市保荐书出具日，保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发行人实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；

5、截至本上市保荐书出具日，保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系。

五、保荐机构承诺事项

（一）保荐机构对本次发行上市保荐的一般承诺

保荐机构已按照法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，对发行人及其实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。

（二）保荐机构对本次发行上市保荐的逐项承诺

保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会等有关规定对发行人进行了充分的尽职调查和辅导，保荐机构有充分理由确信发行人至少符合下列要求：

- 1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会、深圳证券交易所有关证券发行上市的相关规定；
- 2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
- 3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；
- 4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；
- 5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
- 6、保证上市保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
- 7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；
- 8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施，并接受深圳证券交易所的自律监管；
- 9、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他事项。

六、保荐机构对本次发行上市的推荐结论

在充分尽职调查、审慎核查的基础上，保荐机构认为，志橙半导体首次公开发行股票并在创业板上市符合《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件中有关首次公开发行股票并在创业板上市的条件，同意推荐志橙半导体本次发行上市。

七、本次证券发行履行的决策程序

经核查，发行人已就首次公开发行股票并在创业板上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及深圳证券交易所有关规定的决策程序，具体如下：

2023年4月28日，发行人召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》等与本次发行上市有关的议案。

2023年5月19日，发行人召开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》等与本次发行上市有关的议案。

八、保荐机构关于发行人是否符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件的逐项说明

（一）发行人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第2.1.1条之“（一）符合中国证券监督管理委员会规定的创业板发行条件”规定

1、经核查发行人设立至今的营业执照、公司章程、创立大会文件、评估报告、审计报告、验资报告、工商档案等有关资料，发行人的前身志橙有限成立于2017年12月，2022年12月志橙有限按截至2022年8月31日经审计的账面净

资产折股整体变更为股份有限公司。保荐机构认为，从有限责任公司成立之日起计算，发行人持续经营时间在三年以上，且具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《注册办法》第十条的规定。

2、经核查发行人股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、董事会专门委员会议事规则、独立董事制度、董事会秘书制度、发行人相关会议文件、组织机构安排等文件或者资料，保荐机构认为，发行人已经具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《注册办法》第十条的规定。

3、经核查发行人的会计记录、记账凭证等资料，结合天职会计师出具的《审计报告》（天职业字[2023]43888号），保荐机构认为，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年一期财务会计报告由注册会计师出具了无保留意见的审计报告，符合《注册办法》第十一条第一款的规定。

4、经核查发行人的内部控制流程及内部控制制度，结合天职会计师出具的标准无保留结论的《关于深圳市志橙半导体材料股份有限公司内部控制鉴证报告》（天职业字[2023]43888-3号），保荐机构认为，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具了无保留结论的内部控制鉴证报告，符合《注册办法》第十一条第二款的规定。

5、经核查发行人业务经营情况、主要资产、专利、商标等资料，实地核查有关情况，并结合实际控制人调查表及对发行人董事、监事和高级管理人员的访谈等资料，保荐机构认为，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易，符合《注册办法》第十二条第（一）项的规定。

6、经核查发行人报告期内的主营业务收入构成、工商档案及聘请董事、监事、高级管理人员的股东大会决议和董事会决议、股东名册及发行人、发行人控股股东、实际控制人确认，并结合北京市金杜律师事务所出具的《律师工作报告》

和《法律意见书》，保荐机构认为，发行人主营业务、控制权和管理团队稳定，最近二年内主营业务和董事、高级管理人员均未发生重大不利变化；实际控制人和受实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近二年实际控制人未发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，符合《注册办法》第十二条第（二）项的规定；

7、经核查发行人资产清单、主要资产的权属证明文件等资料，结合与发行人管理层的访谈、天职会计师出具的《审计报告》（天职业字[2023]43888号）和发行人律师出具的法律意见书，保荐机构认为，发行人不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项，符合《注册办法》第十二条第（三）项的规定。

8、发行人主营业务为用于半导体设备的碳化硅涂层石墨零部件产品的研发、生产、销售，并提供相关碳化硅涂层服务，经核查国家及相关部门对发行人所处行业的相关法律法规、相关部门开具的合规证明等资料，保荐机构认为，发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策，符合《注册办法》第十三条第一款的规定。

9、经核查发行人取得的工商、税务等机构出具的有关证明文件，结合发行人律师出具的法律意见书，保荐机构认为，最近三年内，发行人及其实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，符合《注册办法》第十三条第二款的规定。

10、经核查董事、监事和高级管理人员提供的无犯罪证明及中国证监会等网站公开检索等资料，结合发行人律师出具的法律意见书，保荐机构认为，发行人董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形，符合《注册办法》第十三条第三款的规定。

(二)发行人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 2.1.1 条之“(二)发行后股本总额不低于 3,000 万元”规定

经核查，本次发行前，发行人总股本为 6,000 万股，本次拟公开发行不超过 2,000 万股股票（不含超额配售部分），本次发行后股本总额预计不低于 3,000 万元。

(三)发行人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 2.1.1 条之“(三)公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上”规定

经核查，本次发行后，公司股本总额不超过人民币 4 亿元，本次拟发行股份占发行后总股本的比例预计不低于 25%。

(四)发行人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 2.1.1 条之“(四)市值及财务指标符合本规则规定的标准”规定

根据《深圳市志橙半导体材料股份有限公司关于首次公开发行股票并在创业板上市的申请报告》，发行人选择的具体上市标准为《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 2.1.2 条中规定的第（一）项标准，即“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元”。

经核查，根据天职会计师出具的《审计报告》（天职业字[2023]43888 号），发行人 2021 年度和 2022 年度经审计的归属于母公司所有者的净利润分别为 5,145.75 万元和 11,474.76 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 5,131.15 万元和 11,446.75 万元，最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元，符合发行人选择的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 2.1.2 条中规定的第（一）项标准中的财务指标。

(五)发行人符合《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022 年修订）》第三条第（一）项创业板定位相关指标规定

发行人符合《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022 年修订）》第三条第（一）项创业板定位相关指标规定，具体情况如下：

创业板定位相关指标	是否符合	指标情况
最近三年研发投入复合增长率不低于 15%	☒ 是 ☐ 否	公司最近三年研发投入复合增长率为 150.04%
最近一年研发投入金额不低于 1,000 万元	☒ 是 ☐ 否	公司最近一年研发投入金额为 2,708.90 万元
最近三年营业收入复合增长率不低于 20%	☒ 是 ☐ 否	公司最近三年营业收入复合增长率为 154.83%

(六)发行人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 2.1.1 条之“(五)本所要求的其他上市条件”规定

经核查，发行人符合深圳证券交易所规定的其他上市条件。

综上，经核查，保荐机构认为：发行人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的各项上市条件。

九、保荐机构关于发行人符合创业板定位及国家产业政策的专业判断

保荐机构依据《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022 年修订）》等有关规定，对发行人是否符合创业板定位及国家产业政策的情况进行了全面核查，并对以下方面进行了重点分析与核查：（1）公司的技术创新性情况；（2）公司成长性情况；（3）公司符合创业板行业领域情况；（4）公司符合创业板定位相关指标及其依据；（5）公司符合国家产业政策的情况。

经核查，保荐机构认为：发行人拥有和应用的技术具备先进性，发行人具备较强的创新能力；发行人产品市场空间增长情况良好，报告期内发行人收入、利润变动情况符合成长性特征，发行人成长性主要来源于其核心技术及产品，发行人创新能力能够支撑其成长，发行人成长性可持续；发行人所属行业不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022 年修订）》第五条规定的原则上不支持其申报在创业板发行上市的行业或禁止类行业，发行人主营业务及所属行业与半导体、光伏等众多新兴产业深度融合，发行人不依赖国家限制产业开展业务。因此，发行人符合相关法律法规中对创业板定位的要求及相关指标，符合国家产业政策。

十、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排

主要事项	具体计划
(一) 持续督导事项	持续督导时间为证券上市当年剩余时间及其后三个完整会计年度
1、督导发行人有效执行并完善防止主要股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度	(1) 督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止主要股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；(2) 与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况
2、督导发行人有效执行并完善防止其高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度	(1) 督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；(2) 与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	(1) 督导发行人有效执行《公司章程》《关联交易管理办法》等保障关联交易公允性和合规性的制度，履行有关关联交易的信息披露制度；(2) 督导发行人及时向保荐机构通报将进行的重大关联交易情况，并对关联交易发表意见
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件	(1) 督导发行人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务；(2) 在发行人发生须进行信息披露的事件后，审阅信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件
5、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项	(1) 督导发行人执行已制定的《募集资金管理制度》等制度，保证募集资金的安全性和专用性；(2) 持续关注发行人募集资金的专户储存、投资项目的实施等承诺事项；(3) 如发行人拟变更募集资金及投资项目等承诺事项，保荐机构要求发行人通知或咨询保荐机构，并督导其履行相关信息披露义务
(二) 保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定	(1) 定期或者不定期对发行人进行回访、查阅保荐工作需要的发行人材料；(2) 列席发行人的股东大会、董事会和监事会；(3) 对有关部门关注的发行人相关事项进行核查，必要时可聘请相关证券服务机构配合
(三) 发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定	(1) 发行人已在保荐协议中承诺配合保荐机构履行保荐职责，及时向保荐机构提供与本次保荐事项有关的真实、准确、完整的文件；(2) 接受保荐机构尽职调查和持续督导的义务，并提供有关资料或进行配合

(以下无正文)

(本页无正文,为《国泰君安证券股份有限公司关于深圳市志橙半导体材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》之签字盖章页)

项目协办人:

丁寒玉

丁寒玉

保荐代表人:

金亮

金亮

魏鹏

魏鹏

保荐业务部门负责人:

郁伟君

郁伟君

内核负责人:

刘益勇

刘益勇

保荐业务负责人:

李俊杰

李俊杰

总经理(总裁):

李俊杰

李俊杰

法定代表人/董事长:

朱健

朱健

国泰君安证券股份有限公司

2024年1月26日